

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

转债代码：118049

转债简称：汇成转债

# 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2025年10月14日)

编号：2025-003

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与机构名称 （排名不分先后）	长江证券、中信建投证券、光大证券、国盛证券、中银证券、兴业证券、东方财富证券、平安证券、兴全基金、鹏华基金、浙商基金、中欧基金、西部利得基金、鑫元基金、国寿安保基金、淳厚基金、东方阿尔法基金、华泰保兴基金、万家基金、国泰海通资管、财通资管、光大自营、长城财富保险资管、平安资管、宁泉资产、趣时资产、磐泽资产、磐厚动量、银叶投资、重阳投资、循理资产、混沌资产、南土资产、万泰华瑞、佳翼资本、运舟资本、陆家嘴信托、英大信托
活动时间	2025年10月14日
活动地点	公司会议室
上市公司接待 人员	董事会秘书：奚颢

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司董事会秘书首先向来访机构和投资者介绍公司投资合肥鑫丰科技有限公司（简称“鑫丰科技”）并与鑫丰科技股东华东科技（苏州）有限公司（简称“华东科技”）建立战略合作关系的整体情况，本次投资和战略合作落地后公司将与华东科技基于各自优势，以鑫丰科技为业务发展平台，共同拓展包括 3D DRAM 在内的存储芯片封测业务。</p> <p>整体情况介绍完毕后进入调研问答环节，公司管理层主要就来访机构和投资者关心的如下问题进行解答和交流：</p> <p><b>1、公司在存储芯片封测领域的布局情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>公司将通过对鑫丰科技进行战略投资及与华东科技建立战略合作关系的方式布局 DRAM 封测业务，并持续拓展以 3D DRAM 为主的存储芯片先进封装业务。</p> <p>公司对鑫丰科技的投资分为直接投资与间接投资两个部分。直接投资方面，公司以现金人民币 9,048.41 万元的价格受让华东科技持有的鑫丰科技 18.4414%股权。</p> <p>间接投资方面，公司作为有限合伙人参与投资的私募股权投资基金苏州工业园区晶汇聚鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“晶汇聚鑫”）及合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“晶汇聚芯”）与苏州启鸿创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳中天精艺投资有限公司共同以现金人民币 31,090.97 万元的价格受让芯玦（东阳）半导体有限公司持有的鑫丰科技 44.5756%股权。</p> <p>上述股权转让完成后，公司将直接持有鑫丰科技 18.4414% 股权；通过晶汇聚鑫间接持有鑫丰科技 8.2425%股权，通过晶汇聚芯间接持有鑫丰科技 0.8606%股权，直接及间接合计持有鑫丰科技 27.5445%的股权。</p> <p>本次投资完成后，公司对鑫丰科技构成重大影响，但未形成实际控制，鑫丰科技不会纳入公司合并报表范围。</p> <p><b>2、本次投资及与华东科技达成战略合作的考虑为何？</b></p>
----------------------	---

**答：**华东科技为中国台湾上市公司华东（8110.TW）在境内的子公司，华东自 1995 年起与东芝半导体合作 DRAM 封装业务，是全球最早涉足 DRAM 封装业务的厂商之一，已覆盖 LPDDR1 至 LPDDR5 全系列产品，客户已覆盖全球主要 DRAM 头部厂商，并凭借其集团集成电路板块资源拓展 3D DRAM 封测业务。

公司与华东科技达成战略合作旨在充分发挥双方资源优势，以鑫丰科技为业务发展平台，围绕合肥当地产业集群就 DRAM 封装业务开展深度合作。在此基础上，综合公司在下游消费电子端积累的深厚客户资源优势及资金优势，以及华东科技及其兄弟公司在 3D CUBE 解决方案方面积累的技术优势，共同拓展 3D DRAM 先进封装技术在境内的落地及应用，填补相关市场空白，以满足 AI 基建时代背景下对 3D DRAM 爆发式增长的市场需求。

### **3、鑫丰科技目前营运情况如何？后续存在何种发展规划？**

**答：**鑫丰科技自成立以来由于固定资产投资较重，叠加 DRAM 景气度周期波动，目前尚处于亏损状态。

鑫丰科技凭借其原母公司华东科技在 DRAM 封测领域深厚的技术工艺积累，基于掌握的 PoP 堆叠封装工艺，是境内最早为长鑫存储提供 LPDDR 封装配套的封测厂商之一，亦是长鑫存储供应体系中少数具备 LPDDR5 量产封装能力的重要合作伙伴，目前具备约 2 万片/月 wafer 封装产能，在 DRAM 封测领域具备较好的业务基础和技术先进性。

本次投资完成后，公司将协同本地国有投资平台及其他产业合作伙伴，持续对鑫丰科技追加投资，助力其于 2027 年底前 DRAM 封装产能提升至 6 万片/月，使其充分受益于长鑫存储等存储芯片龙头厂商产能扩张对产业链上下游厂商的带动效应，并同步拓展定制化 DRAM 解决方案及 3D DRAM 先进封装业务，进一步打开市场空间。

	<p><b>4、本次投资完成后预计对公司的影响情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>本次投资完成后，公司对鑫丰科技构成重大影响，但未形成实际控制，鑫丰科技不会纳入公司合并报表范围，其营业收入不会计入公司合并范围。由于公司在鑫丰科技的权益比例相对较小，预计其亏损对公司财务报表造成的影响相对较小。</p> <p>本次投资是公司进军存储芯片封测领域的战略布局。公司通过对鑫丰科技进行战略投资，依托其具备丰富封装工艺及产品开发经验的成熟团队，以及直接客户验证及终端客户认证的优势，可实现逐步切入存储芯片封测领域的战略目标。</p> <p>同时，投资鑫丰科技对于公司深度融入合肥本地产业集群，围绕产业龙头企业开展业务布局，享受区域性产业集群发展红利同样具有重要意义。公司在过往发展中受益于合肥显示面板及上游显示驱动芯片产业集群的协同发展效应，参股鑫丰科技之后，公司势必也将从合肥本地存储芯片产业集群协同发展中持续受益。</p> <p>此外，投资鑫丰科技是公司与中国台湾知名厂商共同拓展高端先进封装业务的基础，有助于填补境内存储芯片领域先进封装市场空白。</p>
<p><b>是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>否。公司直接、间接投资鑫丰科技以及与华东科技建立战略合作关系，均未达到公告披露和董事会审议的标准。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>上传日期</b></p>	<p>2025年10月14日</p>